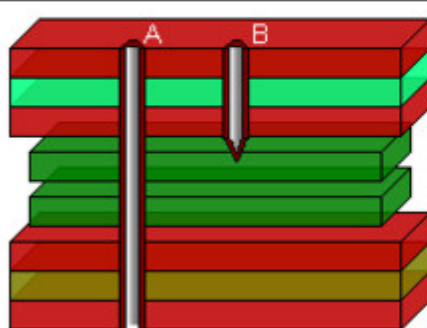


Lagenaufbau

Ebene		Komponente	Dicke (mm)	Cu (my)	Typ
1		Cu+galv.Cu		18+25	
		HF Tr-Lam	0.25	18	
Cu			18		
FR4 Prepreg		0.048		106	
FR4 Prepreg		0.048		106	
Cu			18		
FR4 Tr-Lam		0.51	18+25		
Cu+galv.Cu			18+25		

Presslingsdicke *	0,94	+/- 10%
Gesamtdicke inkl. galv. Cu u. Lötstopmmaske *	1,05	+/- 10%

Bemerkungen zum Lagenaufbau:

- * Dickenberechnung bei 50% Kupferbelegung auf Innenlagen (abhängig von Basismaterialtyp, gewählter Kupferdicke und Kupferbelegung abweichende resultierende Isolations- und Enddicken)
- Dickentoleranz Basismaterial +/-10%
- minimale Kupferenddicken gemäß IPC 6012 aktuelle Ausgabe
- unsymmetrischer Mischaufbau - Verwindung / Wölbung > 0,75% möglich

Designrules zum Lagenaufbau

Durchgangslöcher [A] (Vias)	End-Ø	≥ 150 µm
	Viapad-Ø	≥ 450 µm

Sacklöcher [B] (mechanical blind Vias)	End-Ø	≥ 300 µm
	Viapad-Ø	≥ 600 µm
Leiterbild Außenlagen		
Standard	Leiterbreite bei 18 µm Grundkupfer	≥ 100 µm
	Leiterabstand bei 18 µm Grundkupfer	≥ 120 µm
Leiterbild Innenlagen		
Standard	Leiterbreite bei 18 µm Grundkupfer	≥ 65 µm
	Leiterabstand bei 18 µm Grundkupfer	≥ 80 µm